

公司代码：603501

公司简称：韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾渊	任冰
电话	021-50805043	021-50805043
办公地址	上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼	上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼
电子信箱	stock@sh-willsemi.com	stock@sh-willsemi.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,417,994,907.70	2,824,908,203.63	20.99
归属于上市公司股东的净资产	1,444,946,364.67	1,179,764,415.88	22.48
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-291,878,763.56	26,635,726.15	-1,195.82
营业收入	1,895,428,330.96	914,527,448.10	107.26
归属于上市公司股东的净利润	155,787,222.76	58,810,124.22	164.90

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,714,657.42	47,076,537.34	222.27
加权平均净资产收益率(%)	11.78	6.64	增加5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.15	126.66

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)		17,053				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
虞仁荣	境内自然人	61.30	279,435,000	279,435,000	质押	181,810,205
吕焯	境内自然人	3.51	15,990,000	-	质押	9,601,200
南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.30	10,485,000	-	冻结	1,985,112
周钺	境内自然人	2.18	9,945,000	-	无	-
方荣波	境内自然人	1.71	7,800,000	-	质押	4,000,000
马剑秋	境内自然人	1.71	7,798,000	3,898,000	质押	1,200,000
纪刚	境内自然人	1.59	7,240,000	3,340,000	质押	1,200,000
北京富汇合力投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.54	7,020,000	-	无	-
北京泰利湃思科技有限公司	境内非国有法人	1.09	4,988,880	-	无	-
贾渊	境内自然人	1.05	4,775,000	3,800,000	质押	600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)为受同一基金管理人深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理的私募基金,为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司实现营业总收入 18.95 亿元，同比增长 107.26%；归属于上市公司股东的净利润 1.56 亿元，同比增长 164.90%；剔除公司 2018 年限制性股票股权激励摊销费用的影响，归属上市公司股东的净利润 2.67 亿元，同比增长 354.70%。

（一）深化 IC 设计布局，设计业务稳步增长

报告期内，公司进一步加大 TVS、MOSFET、电源 IC 等产品的研发升级，提高产品性能，实现产品更新换代，进一步补充不同应用市场所需求的产品规格。

在电源管理芯片领域，公司原有的产品技术在不断进行技术升级，以提高产品性能。公司 2017 年重点研发的低压高性能 LDO、DC-DC 已顺利完成工程流片及测试，并实现量产销售。产品性能达到国际先进水平。公司将继续加大高压高性能 LDO、DC-DC、Charge 的产品市场和技术调研力度及研发投入，为今后高压高性能的电源管理芯片技术奠定基础。

在射频芯片领域，公司持续进行高性能手机天线调谐产品、基于 CMOS 的低成本 3G 射频前端套片的研发和量产导入工作，并将加大 NB-IoT 射频前端的研发工作。公司主力推进 RF Switch、LTE LNA、GPS LNA、TIA 等高性能射频芯片的研发工作。公司研发的射频芯片采用 CMOS 工艺，有高端、中端和低成本芯片类型，综合考虑客户对高性能及低成本的需求。公司研发的射频芯片广泛应用在具有 4G 通信功能的智能终端上，目前已实现较明显的业绩增长。

在传感器芯片领域，公司研发了多款 MEMS 芯片产品，应用于麦克风产品，覆盖了智能手机、音箱、电视机顶盒遥控器、安防、线控耳机等麦克风市场的主要领域。公司根据应用领域的差异，分别推出了不同尺寸、灵敏度、功耗程度等差异化产品。报告期内，公司硅麦产品已顺利导入客户。公司将在完善模拟麦克风产品线的基础上，重点加大对数字麦克风产品的研发投入，丰富公司的产品类型。

在直播芯片领域，公司继续进行直播卫星高清解码芯片的研发和卫星解调芯片在汽车电子应

用领域的方案开发。根据应用市场的调查反馈，公司对直播卫星高清解码芯片产品进行有针对性的调整，从而达到降低芯片成本的目的。针对新型宽带数字多媒体广播，目前新一代卫星移动多媒体地面试验网已正式启动，公司配合运营服务商与多家车载终端开发企业开发了卫星移动多媒体车载终端的前装方案和后装方案，公司实现了标准化样机的性能需求，具备相关的核心专利技术，在技术上处于领先和主导地位。

在宽带载波芯片领域，公司应对目前电力系统智能化、自动化的必然趋势，针对国家智能电网建设过程中对宽带电力线载波技术的需求，子公司上海矽久于 2017 年初立项启动宽带载波芯片研发，并已顺利加入国家电网智能量测联盟及物联网工作组，目前公司宽带载波芯片已成功流片，并将尽快推动量产。

2018 年上半年，公司半导体设计业务实现收入 4.18 亿元，较上年同期增长 37.74%。

（二）半导体分销业务销售创新高，客户开发继续取得突破

2018 年上半年，公司半导体分销业务实现收入 14.78 亿元，较上年同期增长 141.77%，公司通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的营销模式，形成差异化的竞争优势，并不断丰富代理的产品线类型，新客户开发继续取得突破。公司注重应收账款的管控，通过客户回款监控体系控制分销业务的规模风险。

（三）持续加大研发投入，不断创新研发机制

2018 年上半年，公司研发投入 0.66 亿元，同比增长 51.87%，占营业总收入的比例为 3.48%，半导体设计业务研发投入占半导体设计业务销售收入比例达到 12.17%。

公司十分重视自主知识产权技术和产品的研发，建立了以客户需求为导向的研发模式，不断创新研发机制，注重技术保护和人才培养。公司重视研发团队的建设，核心研发团队稳定，同时招纳了一批具有海外背景的科研人员，新组建了全资或控股子公司研发新产品，为后续发展进行战略布局。截至本报告出具日，公司已拥有专利 57 项，其中发明专利 16 项，实用新型 41 项；集成电路布图设计权 74 项；软件著作权 69 项。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用